

案例介绍-某半导体制造企业CIM集成项目

此项目为该企业建设12寸FAB的CIM集成项目，项目特点是：

- 项目规模较大：基础架构硬件合同金额过亿
- 沟通难度大：客户团队在国外
- 要求高：国外客户团队对人员及文档的要求较高
- 项目参与人员多：规划设计阶段人员21人



项目最终由于某些原因在进行到设备部署安装时项目被暂停

项目目标

- 1: 完成MFG/Corp系统所有网络（包括安全）、服务器、存储、备份设备、系统、数据库和防病毒的规划设计
- 2: 协调各个硬件厂商、数据库厂商、国外应用团队的资源，根据客户需求进行整体进度控制
- 3: 根据客户要求的各个时间点提供合理化建议并阶段性交付设计文档给客户项目团队
- 4: 项目阶段性知识转移和培训

案例介绍-某半导体制造企业CIM集成项目

